

浙江晶盛机电股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关规定，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行对主要财务指标的影响

（一）主要假设和前提条件

1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行于 2021 年 12 月实施完成，该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

3、公司 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润分别为 85,815.99 万元和 81,996.46 万元。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润较上一年度保持持平、增长 10%、增长 20%，且假设扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利

润增长比例也保持一致。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；

4、假设本次向特定对象发行募集资金总额上限为 570,000.00 万元(含本数)，不考虑发行费用，实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

5、假设本次向特定对象发行股份数量上限为 257,112,600 股（含本数），若公司在本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数量将进行相应调整；

6、假定不考虑限制性股票解锁对每股收益的影响，不考虑现金股利对计算每股收益的影响，不考虑未解锁的限制性股票对稀释每股收益的影响；

7、在预测公司总股本时，以截至本预案出具日公司总股本 1,285,563,394 股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；

8、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；

9、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；

10、假设不考虑本次向特定对象发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

以上假设分析仅作为示意性测算本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

以上假设分析仅作为示意性测算本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设和前提，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目	2020年12月31日/2020年度	2021年12月31日/2021年度	
		本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	128,568.94	128,556.34	154,267.60
本次发行募集资金总额（万元）	570,000.00		
假设情形一：公司 2021 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润与 2020 年度持平			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	85,815.99	85,815.99	85,815.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	81,996.46	81,996.46	81,996.46
基本每股收益（元/股）	0.67	0.67	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.67	0.67
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.64	0.64	0.64
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.64	0.64	0.64
假设情形二：公司 2021 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较 2020 年度增长 10%			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	85,815.99	94,397.59	94,397.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	81,996.46	90,196.11	90,196.11
基本每股收益（元/股）	0.67	0.73	0.73
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.73	0.73
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.64	0.70	0.70
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.64	0.70	0.70
假设情形三：公司 2021 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较 2020 年度增长 20%			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	85,815.99	102,979.19	102,979.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	81,996.46	98,395.75	98,395.75
基本每股收益（元/股）	0.67	0.80	0.80
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.80	0.80

项目	2020年12月 31日/2020年 度	2021年12月31日/2021年度	
		本次发行前	本次发行后
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.64	0.77	0.77
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.64	0.77	0.77

注：每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

根据上述测算，在完成本次发行后，公司总股本将会相应增加，但由于募集资金产生效益需要一定时间，短期内每股收益等指标存在被摊薄的风险。

二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次向特定对象发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，但募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间。本次向特定对象发行完成后，公司的每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄的风险。

同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对2021年归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次发行的必要性和合理性详见《浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票预案》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司是国内领先的半导体材料装备和LED衬底材料制造的高新技术企业,以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为使命，围绕

硅、碳化硅、蓝宝石三大主要半导体材料开发出一系列关键设备，并适度延伸到材料领域。

本次发行募集资金投入的项目与公司主营业务密切相关，项目实施后，公司将强化在半导体材料装备领域的先发优势，并积极布局半导体产业的下一代关键技术。本次发行将有利于公司合理布局业务板块、实现公司战略目标，充分整合优势资源、增强核心竞争力，加快规模化发展、提升综合实力，符合公司长远发展目标和股东利益。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司始终重视人才队伍建设，多年来持续通过自主培养和人才引进相结合的方式扩充人才队伍，在研发、生产制造及经营管理等各个领域建立了专业化程度高、综合素质强的人才梯队。公司已建立起一支以教授、博士、硕士为核心的研发团队，以及一支专业化程度高、应用经验丰富、执行力强、具备熟练掌握晶体设备制造技术和晶体材料工艺技术的技术工程师队伍，核心技术人员充分发挥了在持续技术和产品创新方面的攻坚和基石作用。此外，公司通过对技术、业务骨干、中层管理等核心员工实施限制性股票激励计划，提升了员工工作积极性，确保人才队伍的稳定持续发展。

2、技术储备

经过多年的科研攻关和技术创新，公司积极布局“长晶、切片、抛光、外延”四大核心环节设备的研发，在半导体材料用关键设备领域实现国产化突破。公司通过承担国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目的“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”和“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”两项课题，实现集成电路8-12英寸半导体长晶炉的量产突破。并以此为基础，成功开发了6-8英寸用晶体滚圆机、截断机、切片机、双面研磨机、边缘抛光机、单面抛光机、外延生长、LPVCD等设备并形成销售；同时成功开发了12英寸用晶体滚圆机、截断机、双面研磨机、边缘抛光机、双面抛光机、最终抛光机等设备。公司最新开发出第三代半导体碳化硅长晶炉、抛光机、外延设备，已完成技

术验证，未来随着下游应用市场的发展，将为公司发展注入新动力。此外，公司近年来布局的半导体抛光液、阀门、磁流体部件、16-36英寸坩埚等零部件耗材领域，随着产业的发展已逐步显现出了良好的发展势头。

截至2021年6月30日，公司及下属子公司共有有效专利476项，其中发明专利61项。

3、市场储备

公司自创建以来，通过持续的自主技术创新、不断提升产品品质和专业化的技术支持服务，在半导体产业领域高端客户群中建立了良好的品牌知名度，在行业内拥有较高的声誉。公司是连续5年的中国半导体设备行业十强单位和中国电子专用设备行业十强单位，并荣获了“2019全国电子信息企业创新企业奖”、“中国创业板最具成长性上市公司十强”等荣誉。2019年，公司“大尺寸半导体硅单晶生长设备的关键技术”荣获中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会联合授予的第十三届（2018年度）中国半导体创新产品和技术奖项。2020年，公司获得“浙江省政府质量管理创新奖”，获得人力资源和社会保障部授予“国家级博士后科研工作站”，并被浙江省科学技术厅评为“浙江省第四批创新型领军企业”。公司的主要客户包括中环股份、有研新材、合晶科技、上海新昇等业内知名的上市公司或大型企业，并与公司保持了长期的战略合作关系，彼此建立了深厚的互信合作，共同促进行业快速发展。公司品牌影响力和客户优势进一步提升，对公司开拓下游市场产生积极影响。

五、公司应对本次发行股票摊薄即期回报采取的措施

为了保护投资者利益，降低本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次募集资金有效使用，增强资产质量，提升公司的业务规模、经营效益，实现公司的可持续发展，具体措施如下：

（一）完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独

立董事、高级管理人员的公司治理结构，确保股东权利能够得以充分行使；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，科学、高效地进行决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

（二）加快募投项目建设进度，尽早实现预期收益

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，公司将严格按照国家相关法律法规及中国证监会的要求，对募集资金进行专项存储，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施进度，争取早日达产并实现预期效益，争取早日实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

（三）加强技术研发，提升核心竞争力

公司将持续以技术创新和对客户需求深度挖掘的双轮驱动模式加强研发投入和技术创新，充分利用行业快速发展的机遇，继续加大研发投入，进一步改善研发条件，完善技术创新的相关制度，加强对创新人才的激励机制，充实研发团队，强化与高校、科研院所的长效合作机制，继续巩固行业领先优势，创造技术护城河，推动新产品迭代，提升对产业发展的引领能力，为公司增强核心竞争力、保持技术先进性提供必要的保障。

（四）严格执行现金分红，优化投资者回报机制

公司严格遵守中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规章制度，并在《公司章程》、《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等文件中明确了分红规划。本次发行完成后，公司将继续严格执行《公司章程》以及《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等文件的内容，并结合公司经营情况，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。

六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

（一）控股股东、实际控制人的承诺

为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施；

2、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺；

3、如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本公司/本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

（二）董事、高级管理人员的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，维护中小投资者利益，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺切实履行本承诺，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任；

7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

董事会对公司本次发行摊薄即期回报事项的分析及被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并将提请公司股东大会予以审议。

公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关主体承诺的履行情况。

特此公告

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2021年10月26日